

Модуль містить герметичний електро- і теплопровідний корпус із рознімом та кришками і розташованими усередині мікросбірками. Безкорпусні мікросбірки поміщені щонайменше у два герметичні екрановані об'єми навпроти одна одної на екранну поверхню тонких друкованих плат, приклеєних або припаяних до теплопровідної і екрануючої перегородки, яка розділяє корпус щонайменше на два об'єми. Рознім безпосередньо входить виводами у корпус через ізольовані діелектриком прохідні трубчасті контакти.